



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
 RECOMMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 基板厚: 1.6 ± 0.1

NUMBER 316517
 METRIC
 三線法(3rd ANGLE PROJECTION)
 PROJ NO. 395-623
 単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J
 REV.10/83

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0
 コンタクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38 μm MIN
- △3. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76 μm MIN
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6 △4	↑	-5
△6 △3		-3
△6 △2		316517-2
FINISH	型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1995 Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
名称 (NAME)		DYNAMIC (D-3500) 20 POS. V HDR. ASS'Y			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		10mm以下: ±0.35	10mm以上 30mm以下: ±0.4	30mm以上 100mm以下: ±0.45	角 度: ±3'
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE)		仕上 (FINISH) (SEE NOTE)		LOC	番号 (No.)
B REVISED (FJD0-0039-03) TS J.M. 10/24 '93		A REVISED (FJD0-0114-03) TS SM 10/24 '93		A3	J
O RELEASED FJ00-3261-95 NM Y.I. 10/24 '95		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		C-316517	
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		尺度 (SCALE)	REV.
CHK. 24 OCT 95 Y.ISHIKAWA		APP. 24 OCT 95 S.MANABE		2/1	B
				SHEET	1 OF 1